

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年 9月18日

出願番号 Application Number: 特願2003-326638

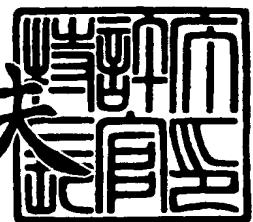
[ST. 10/C]: [JP2003-326638]

出願人 Applicant(s): 株式会社村田製作所

2003年10月 8日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井 康夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 32-0528P
【提出日】 平成15年 9月18日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 H01L 21/56
H01L 21/60

【発明者】
【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目 26番10号 株式会社村田製作所内
【氏名】 霞末 和男

【発明者】
【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目 26番10号 株式会社村田製作所内
【氏名】 梶川 武久

【発明者】
【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目 26番10号 株式会社村田製作所内
【氏名】 八戸 啓

【特許出願人】
【識別番号】 000006231
【氏名又は名称】 株式会社村田製作所
【代表者】 村田 泰隆

【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】 特願2002-330686
【出願日】 平成14年11月14日

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 005304
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲**【請求項 1】**

チップ部品をフリップチップ実装した基板上に、ディスペンサニードルから樹脂を供給して、前記チップ部品の側面と前記ディスペンサニードルの側面との間に樹脂溜りを形成する工程と、

前記樹脂溜りの樹脂を前記チップ部品と前記基板との隙間に充填する工程と、を含むことを特徴とする回路モジュールの製造方法。

【請求項 2】

チップ部品をフリップチップ実装した基板を、熱源を内蔵する台座に設置して加熱する工程と、

前記基板上にディスペンサニードルから樹脂を供給して、前記チップ部品の側面と前記ディスペンサニードルの側面との間に樹脂溜りを形成する工程と、

前記樹脂溜りの樹脂を前記チップ部品と前記基板との隙間に充填する工程と、を含むことを特徴とする回路モジュールの製造方法。

【請求項 3】

前記チップ部品の側面と前記ディスペンサニードルの側面との間に毛細管現象によって樹脂が溜まる速度が、前記チップ部品と前記基板との隙間に前記樹脂が充填される速度よりも速いことを特徴とする、請求項1あるいは請求項2に記載の回路モジュールの製造方法。

【請求項 4】

前記樹脂溜まりの樹脂を前記チップ部品と前記基板との隙間に充填する工程において、

前記樹脂溜まりの樹脂が前記隙間に充填されるまで前記ディスペンサニードルの位置が固定されつづけていることを特徴とする、請求項1ないし請求項3のいずれか一項に記載の回路モジュールの製造方法。

【請求項 5】

前記樹脂溜まりを形成する工程において、前記チップ部品の側面と前記ディスペンサニードルの側面との距離が0.15mmよりも小さいことを特徴とする、請求項1ないし請求項4のいずれか一項に記載の回路モジュールの製造方法。

【請求項 6】

前記チップ部品が、ペアチップであることを特徴とする、請求項1ないし請求項5のいずれか一項に記載の回路モジュールの製造方法。

【請求項 7】

前記回路モジュールが、高周波回路モジュールであることを特徴とする、請求項1ないし請求項6のいずれか一項に記載の回路モジュールの製造方法。

【請求項 8】

前記樹脂が、エポキシ系樹脂であることを特徴とする、請求項1ないし請求項7のいずれか一項に記載の回路モジュールの製造方法。

【請求項 9】

前記ディスペンサニードルの側面は、撥水性の物質によりコーティングされていることを特徴とする、請求項1ないし請求項8のいずれか一項に記載の回路モジュールの製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】回路モジュールの製造方法

【技術分野】

【0001】

本発明は、半導体チップなどのチップ部品を基板上にフリップチップ実装した後に、チップ部品と基板との間を樹脂で封止してなる回路モジュールの製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

半導体チップ等のチップ部品を基板にフリップチップ実装したのちに、チップ部品と基板との隙間を樹脂で封止し、チップ部品と基板との熱膨張係数の違いによって生じる応力が接続電極に集中することを防止する工程は、フリップチップ実装技術にとって欠かせない工程である。

【0003】

基板上に一面に樹脂を塗布する方法が用いられることがあるが、樹脂が付着することにより正常に動作しなくなる部品が基板上に存在する場合には、チップ部品と基板との隙間にのみ樹脂を充填する方法がとられる。

【0004】

そのような技術として、例えば特許文献1で開示されている技術がある。この技術では、図2 (a) に示すような、接合電極3を介してチップ部品2を基板1に実装したフリップチップ実装体の一部側に、図2 (b) に示すように樹脂6を塗布する。そして図2 (c) に示すように、これを密閉した容器8に入れ、熱源を内蔵する台座4によって樹脂6を加熱するとともに容器8内の圧力を減圧装置9によって減圧して、このときに生じる空気の流れを利用して、図2 (d) に示すようにチップ部品2と基板1との隙間に樹脂6を充填する。

【特許文献1】特開平8-241900号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、上記の特許文献1に開示された技術では、容器8の密閉、減圧等の管理が面倒であり、また、減圧装置9が必要であるため、製造設備が大掛かりになり、製造コストの上昇を招いている。

【0006】

加えて近年は、回路モジュールの小型化の要請が強く、基板への部品の実装密度の向上が求められており、封止に用いる樹脂がチップの外側へ大きく広がらないような工法が求められている。また、回路の高周波化に伴い、一般にQ値が悪い樹脂が基板上に大きく広がると回路モジュールの特性の劣化を招くため、その理由からも、基板上への樹脂の不要な広がりは好ましくない。

【0007】

よって、本発明の目的は、簡単な装置を用いて、基板上への不要な樹脂の広がりを防ぎつつチップ部品と基板との隙間に樹脂を充填できる回路モジュールの製造方法を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0008】

上記問題点を解決するために請求項1に記載の回路モジュールの製造方法は、チップ部品をフリップチップ実装した基板上に、ディスペンサニードルから樹脂を供給して、前記チップ部品の側面と前記ディスペンサニードルの側面との間に樹脂溜りを形成する工程と、前記樹脂溜りの樹脂を前記チップ部品と前記基板との隙間に充填する工程と、を含むことを特徴とする。

【0009】

チップ部品の側面とディスペンサニードルの側面との隙間に樹脂溜まりを形成し、樹脂

溜まりの樹脂をチップ部品と基板との隙間に充填することにより、ディスペンサニードルが、チップ部品と反対方向に樹脂が流れることを防ぎ、基板上への不要な樹脂の広がりを防ぐことができる。また、樹脂溜まりができればディスペンサニードルからの樹脂の供給を止めても、チップ部品と基板との間に樹脂が充填されていくため、長時間にわたってディスペンサニードルから樹脂を供給しつづける必要がなく、ディスペンサニードルの管理が簡単になる。さらに、減圧装置などを用いる必要がなく、簡単な設備で樹脂の充填が可能であるから、製造コストの低減を図ることができる。

【0010】

また、請求項2に記載の回路モジュールの製造方法は、チップ部品をフリップチップ実装した基板を、熱源を内蔵する台座に設置して加熱する工程と、前記基板上にディスペンサニードルから樹脂を供給して、前記チップ部品の側面と前記ディスペンサニードルの側面との間に樹脂溜りを形成する工程と、前記樹脂溜りの樹脂を前記チップ部品と前記基板との隙間に充填する工程と、を含むことを特徴とする。

【0011】

基板を加熱することにより、基板上に供給された樹脂の粘度が下がり、チップ部品と基板との隙間に樹脂が充填される速度が速くなる。

【0012】

また、請求項3に記載の回路モジュールの製造方法は、前記チップ部品の側面と前記ディスペンサニードルの側面との間に毛細管現象によって樹脂が溜まる速度が、前記チップ部品と前記基板との隙間に前記樹脂が充填される速度よりも速いことを特徴とする。

【0013】

ディスペンサニードルから供給された樹脂は、毛細管現象によってディスペンサニードルの側面とチップ部品との側面の間に溜まるとともに、毛細管現象によってチップ部品と基板との隙間に入り込んでいく。チップ部品の側面とディスペンサニードルの側面との間に樹脂が溜まる速度が、チップ部品と基板との隙間に前記樹脂が充填される速度よりも速くなるようにすることによって、樹脂溜まりが速やかに形成される。

【0014】

また、請求項4に記載の回路モジュールの製造方法は、前記樹脂溜まりの樹脂を前記チップ部品と前記基板との隙間に充填する工程において、前記樹脂溜まりの樹脂が前記隙間に充填されるまで前記ディスペンサニードルの位置が固定されつづけていることを特徴とする。

【0015】

ディスペンサニードルを固定しつづけることにより、樹脂溜まりの樹脂は速やかに隙間に充填され、また、チップ部品と反対方向への樹脂の不要な濡れ広がりを抑制することができる。

【0016】

また、請求項5に記載の回路モジュールの製造方法は、前記樹脂溜まりを形成する工程において、前記チップ部品の側面と前記ディスペンサニードルの側面との距離が0.15mmよりも小さいことを特徴とする。

【0017】

チップ部品の側面とディスペンサニードルの側面との距離を0.15mmよりも小さくすることによって、チップ部品とディスペンサニードルの側面との間に樹脂溜まりが形成されやすくなる。

【0018】

また、請求項6に記載の回路モジュールの製造方法は、前記チップ部品が、ペアチップであることを特徴とする。

【0019】

ペアチップを基板にフリップチップ実装した場合、ペアチップを保護するためにペアチップと基板との隙間に樹脂を充填する必要があり、本発明によれば簡単な装置によって樹脂の充填が可能である。

【0020】

また、請求項7に記載の回路モジュールの製造方法は、回路モジュールが高周波回路モジュールであることを特徴とする。

【0021】

上述したように、一般に封止に用いられる樹脂はQが悪いため、特に良好なQが要求される高周波回路モジュールにおいては、基板上への不要な樹脂の広がりを防ぐ必要性が高い。

【0022】

また、請求項8に記載の回路モジュールの製造方法は、前記樹脂が、エポキシ系樹脂であることを特徴とする。

【0023】

硬化したエポキシ系樹脂は電気絶縁性、接着性、耐熱性などに優れるため、チップ部品と基板との隙間に充填する材料として好適である。

【0024】

また、請求項9に記載の回路モジュールの製造方法は、前記ディスペンサニードルの側面が、撥水性の物質でコーティングされていることを特徴とする。

【0025】

ディスペンサニードルの側面を撥水性の物質でコーティングすることにより、ディスペンサニードルの側面に樹脂が付着することを防ぐことができ、上述のような回路モジュールを連続して製造する場合であっても、ディスペンサニードルから吐出される樹脂の量を安定させることができる。

【発明の効果】

【0026】

以上説明したように本発明によれば、チップ部品の側面とディスペンサニードルの側面との間に樹脂溜まりを形成することにより、チップ部品と反対側への樹脂の濡れ広がりを抑制することができるから、チップ部品の実装面積を小さくし、基板上への部品の搭載密度の向上を図ることができる。

【0027】

また、熱源を内蔵する台座の上に基板を設置して基板を加熱することにより、樹脂の粘度が低下して樹脂の充填速度を速めることができる。

【0028】

また、チップ部品の側面とディスペンサニードルの側面との間に毛細管現象によって樹脂が溜まる速度が、チップ部品と基板との隙間に前記樹脂が充填される速度よりも速くなるようにすることによって、樹脂溜まりが速やかに形成される。

【0029】

また、隙間に樹脂が充填されるまでディスペンサニードルの位置を固定しつづけることにより、樹脂が速やかに隙間に充填されるようになり、加えて、チップ部品と反対側の方向に不要に樹脂が濡れ広がることを抑制できるから、基板上の部品の実装密度を高くすることができる。

【0030】

また、チップ部品の側面とディスペンサニードルの側面との距離を0.15mmよりも小さくすることによって、チップ部品とディスペンサニードルの側面との間に樹脂溜まりが形成されやすくなる。

【0031】

また、一般に封止に用いられる樹脂はQが悪いため、特に良好なQが要求される高周波回路モジュールにおいては、基板上への不要な樹脂の広がりを防ぐ必要性が高いため、本発明を高周波回路モジュールに適用すれば大きな効果がある。

【発明を実施するための最良の形態】

【0032】

【実施例1】

【0033】

以下に、図を用いて本発明の実施例について説明する。図1は本発明の各工程を示す図である。

【0034】

まず、図1(a)に示すように、金属バンプなどの接合電極3を介してチップ部品2がフリップチップ実装されている基板1を、図示しない熱源を内部に有する台座4の上に設置し、ディスペンサニードル5を所定の距離に近づける。ここでは、チップ部品2の側面とディスペンサニードル5の側面との距離Aを0.12mm、ディスペンサニードル5の先端と基板1との距離Bを50μmとした。チップ部品2と基板1との隙間Cは40μmである。

【0035】

次に、台座4をおよそ100度に加熱し、ディスペンサニードル5から所定の量の樹脂6を供給すると、ディスペンサニードル5の側面とチップ部品2の側面との間に毛細管現象によって樹脂溜まり7が形成される。ここで用いた樹脂6は、エポキシ樹脂を主成分とし、フィラーを55重量%含み、100度における粘度が100mPa·sのものである。エポキシ系樹脂は硬化すると電気絶縁性、接着性、耐熱性などに優れるため、隙間に充填するための樹脂6として好適に用いることができる。

【0036】

一定量の樹脂6をディスペンサニードル5から吐出し終えたら、そのまま放置する。すると、樹脂溜まり7に溜まっている樹脂が、図1(c)に示すように毛細管現象によってチップ部品2と基板1との間に充填されていく。このとき、ディスペンサニードル5を図の位置に固定しつづけることによって、図に矢印で示した、チップ部品2とは反対側の方向への樹脂6の濡れ広がりは小さくなる。

【0037】

樹脂溜まり7を形成せずにチップ部品2と基板1との隙間に樹脂6を充填しようとすると、隙間に樹脂6が充填され終わるまでの間、ディスペンサニードル5から樹脂6を一定の速度で供給し続けなければならず、樹脂供給の管理が面倒である。それに対し本発明の方法では、始めに一定量の樹脂6を吐出して樹脂溜まり7を形成しておくことにより、樹脂溜まり7が形成された後はディスペンサニードル5からの樹脂6の供給を止めても、毛細管現象によって自然にチップ部品2と基板1との隙間に樹脂6が充填されていくので、製造工程の管理が簡単である。

【0038】

チップ部品2と基板1との隙間に樹脂6が充填されたら、この回路モジュールをオープンに入れて150度で60分間加熱して樹脂6を硬化させると、樹脂6による封止工程が完成する。

【0039】

その後、必要であれば他の電子部品を基板1上に実装するなどして、本発明の回路モジュールが完成する。

【0040】

なお、上記した樹脂6および諸条件のもとで、チップ部品2の側面とディスペンサニードル5の側面との距離Aの好ましい範囲がある。すなわち、この距離Aを0.2mm、0.15mm、0.12mm、0.1mmとしてそれぞれ実験した結果、A=0.2mmおよびA=0.15mmとした場合には樹脂溜まり7が形成されず、A=0.12mmおよびA=0.1mmとした場合には樹脂溜まり7が形成された。よって、チップ部品2の側面とディスペンサニードル5の側面との距離Aは0.15mmよりも小さくすることが好ましい。

【0041】

また、ディスペンサニードル5の先端と基板1との距離Bの範囲は、20μm(0.02mm)から100μm(0.1mm)の範囲とすることが好ましい。距離Bがこれ以上

大きい場合には樹脂溜まり7が形成されにくく、また、チップ部品2の上方に樹脂が流れ出しやすくなってしまう。さらに、樹脂溜まり7の樹脂がチップ部品2とは反対の方向に流れやすくなつて不所望な樹脂の広がりが発生しやすくなる。逆に距離Bがこれ以上小さい場合には、ディスペンサニードル5の一般的な位置精度の都合上、ディスペンサニードル5と基板1とが接触してしまう可能性が高くなつて好ましくない。

【0042】

ただし、本発明を実施することができる距離Aおよび距離Bの範囲は、例えば樹脂6の粘度や、チップ部品2と基板1との隙間の広さなどによって変化しうるので、本発明の実施範囲がこの範囲に限られるものではない。

【0043】

なお、ディスペンサニードル5の側面は、あらかじめ撥水性の高い物質でコーティングしておくことが好ましい。上記のような回路モジュールの製造を繰り返し行う場合、ディスペンサニードル5の側面に樹脂6が付着しているとディスペンサニードル5から吐出される樹脂の量が不安定になる虞がある。よつて、ディスペンサニードル5の側面を撥水性の高い物質によってコーティングすることによって、ディスペンサニードル5の側面に樹脂が付着することを防ぐことが好ましい。撥水性の高い物質としては、例えばポリテトラフロロエチレンなどを用いることができる。

【図面の簡単な説明】

【0044】

【図1】本発明の各工程を示す図である。

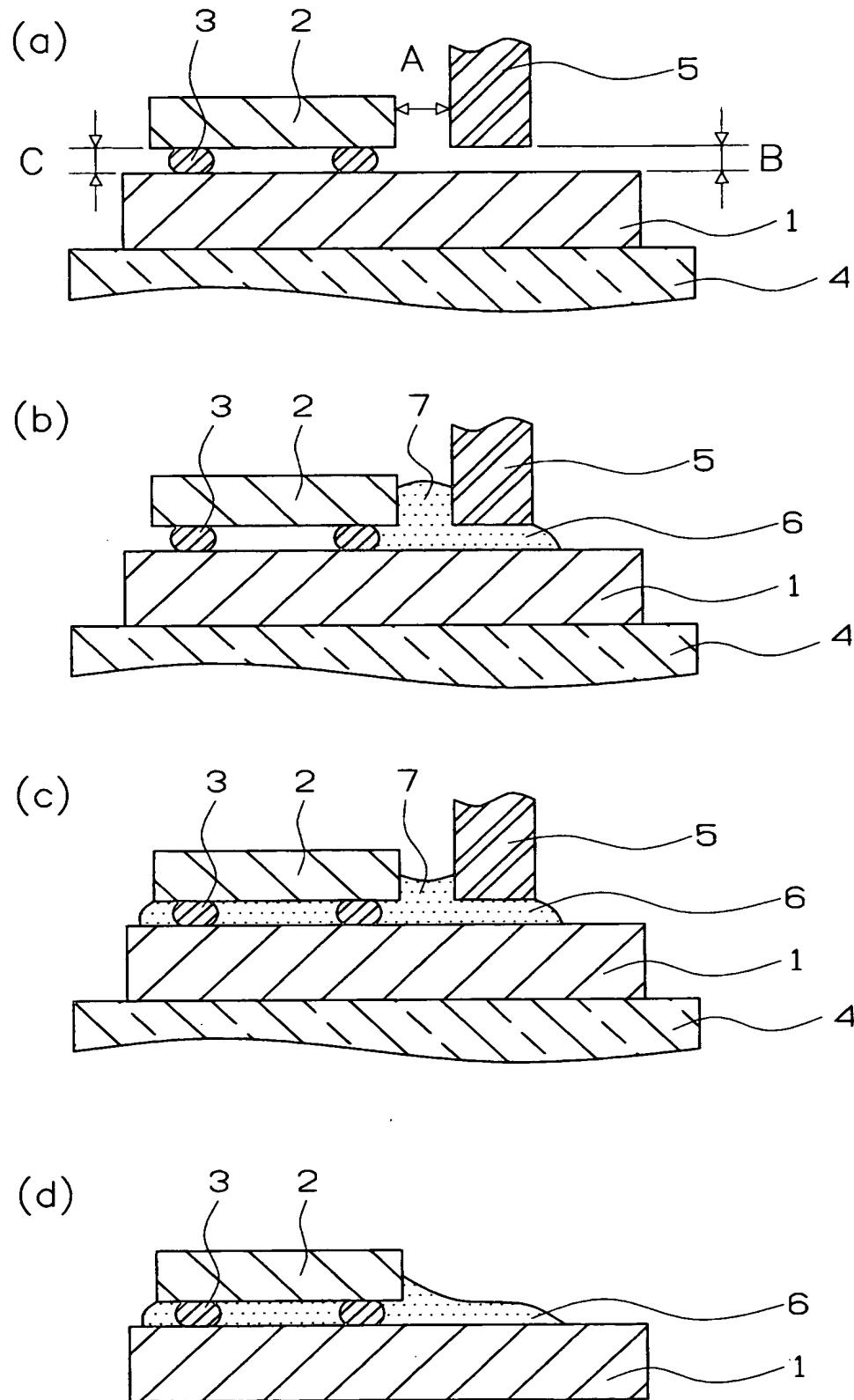
【図2】従来の技術の各工程を示す図である。

【符号の説明】

【0045】

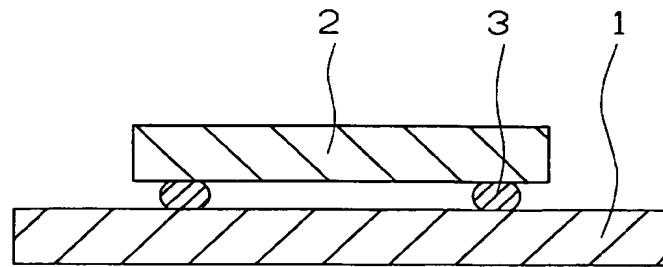
- 1 基板
- 2 チップ部品
- 3 接合電極
- 4 台座
- 5 ディスペンサニードル
- 6 樹脂
- 7 樹脂溜まり
- 8 容器
- 9 減圧装置

【書類名】 図面
【図 1】

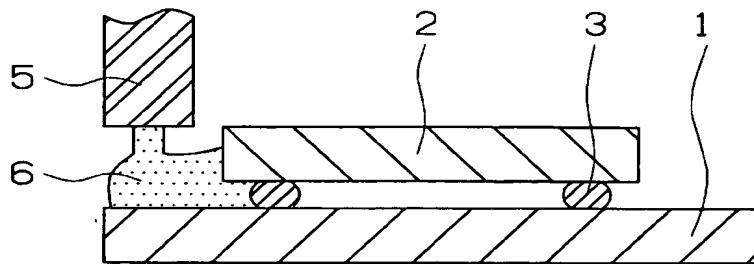


【図2】

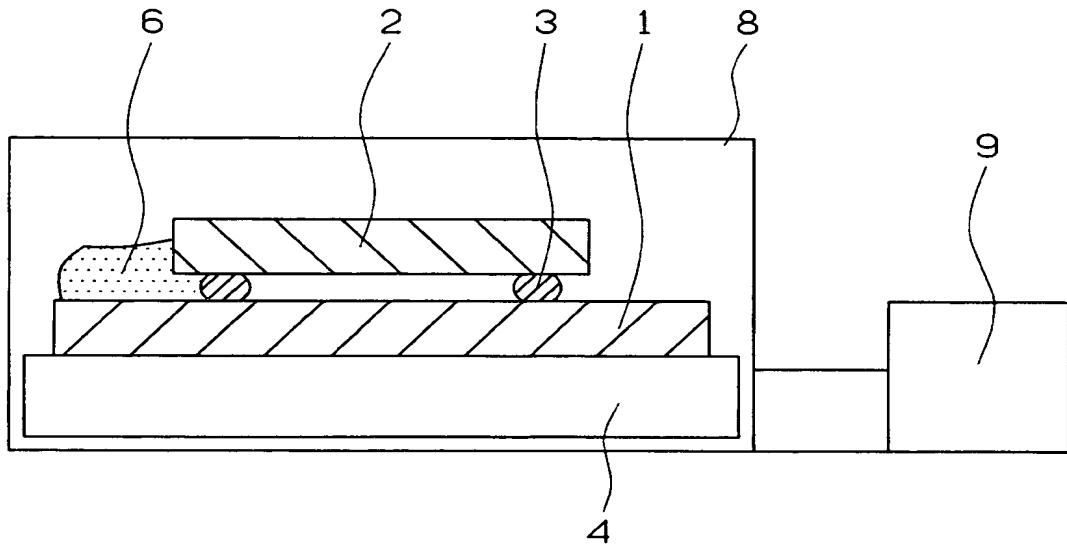
(a)



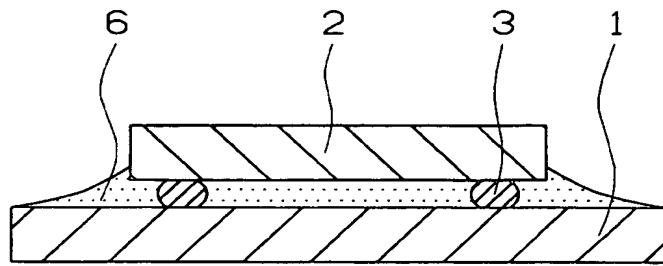
(b)



(c)



(d)



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 チップ部品と、それをフリップチップ実装した基板との間の隙間に樹脂を充填する、回路モジュールの製造方法において、簡単な装置で樹脂の不要な濡れ広がりを小さくする方法を提供する。

【解決手段】 樹脂を供給するディスペンサニードル5の側面とチップ部品2の側面との間に、毛細管現象を利用して樹脂溜まり7を形成し、樹脂溜まり7の樹脂をチップ部品2と基板1との隙間に充填する。

【選択図】

図1

特願 2003-326638

出願人履歴情報

識別番号 [000006231]

1. 変更年月日 1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住 所 京都府長岡市天神二丁目26番10号
氏 名 株式会社村田製作所